

# 2009年3月期 決算説明会

2009年5月1日

東京エレクトロン デバイス株式会社



東京エレクトロン デバイス株式会社

# 2009年3月期 連結業績

(単位:百万円)

	2008年3月期		2009年3月期		増減率 (%)
		百分比%		百分比%	
売上高	112,104	100.0	94,701	100.0	15.5
売上総利益	16,957	15.1	14,709	15.5	13.3
営業利益	3,678	3.3	1,840	1.9	50.0
経常利益	3,849	3.4	2,041	2.2	47.0
当期純利益	2,193	2.0	617	0.7	71.8
1株当たり当期純利益	20,689.48円		5,824.91円		
R O E	10.5 %		2.9%		
1株当たり年間配当金	6,600円		6,600円		
期末従業員数	788人		825人		

# 2009年3月期 連結資産

(単位:百万円)

科目	2008年3月期	2009年3月期	増減額
現預金	1,367	1,245	122
受取手形・売掛金	25,633	15,479	10,154
たな卸資産	17,649	15,879	1,770
その他流動資産	2,354	3,250	896
有形固定資産	1,012	1,334	322
無形固定資産	785	643	141
投資その他の資産	2,654	2,846	191
資産計	51,458	40,680	10,778

# 2009年3月期 連結負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2008年3月期	2009年3月期	増減額
買掛金	13,897	6,706	7,191
短期借入金	6,069	3,806	2,262
その他流動負債	5,616	3,969	1,647
固定負債	4,269	4,784	515
負債計	29,853	19,266	10,586
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	5,645	5,645	-
利益剰余金	13,438	13,351	86
評価・換算差額等	25	79	104
純資産計	21,604	21,413	191
負債・純資産計	51,458	40,680	10,778

# 2009年3月期 連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2008年3月期	2009年3月期	増減額
営業キャッシュ・フロー	381	3,566	3,185
投資キャッシュ・フロー	1,255	801	454
財務キャッシュ・フロー	1,134	2,954	4,089
現金及び現金同等物 期末残高	1,367	1,245	122

# セグメント別 連結売上高

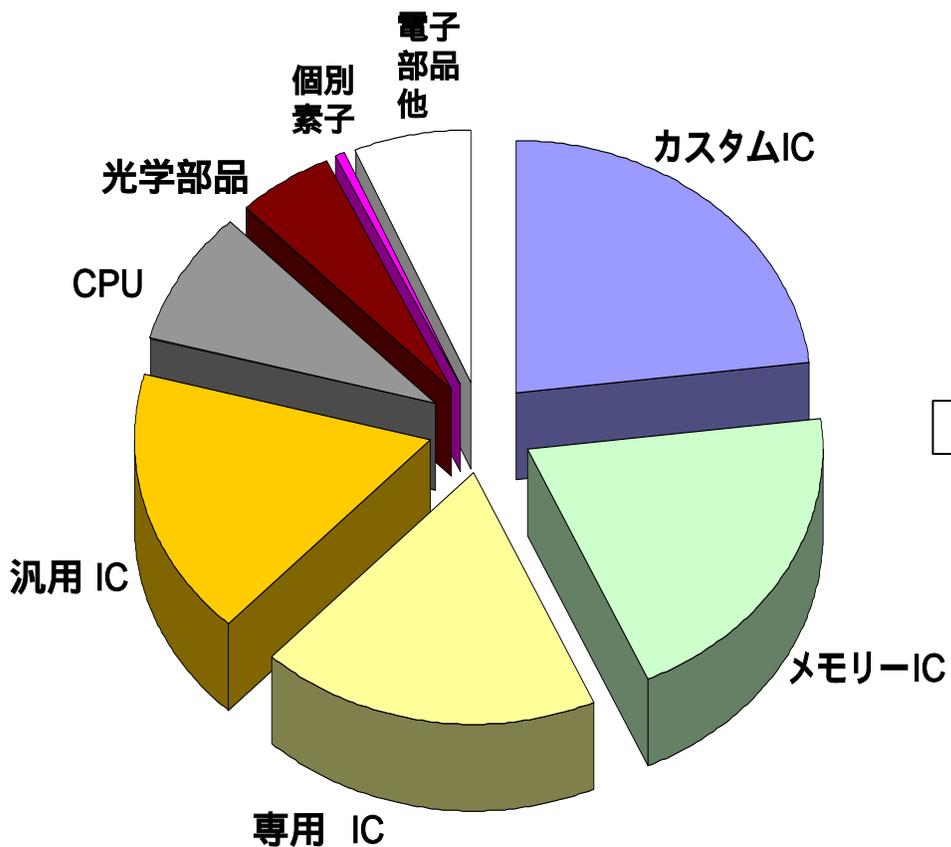
(単位:百万円)

セグメント	2008年3月期		2009年3期		対前年 増減率 (%)
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
半導体及び電子デバイス事業	86,421	77.1	74,980	79.2	13.2
コンピュータシステム関連事業	25,683	22.9	19,721	20.8	23.2
合 計	112,104	100.0	94,701	100.0	15.5

# 半導体及び電子デバイス事業

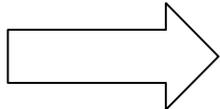
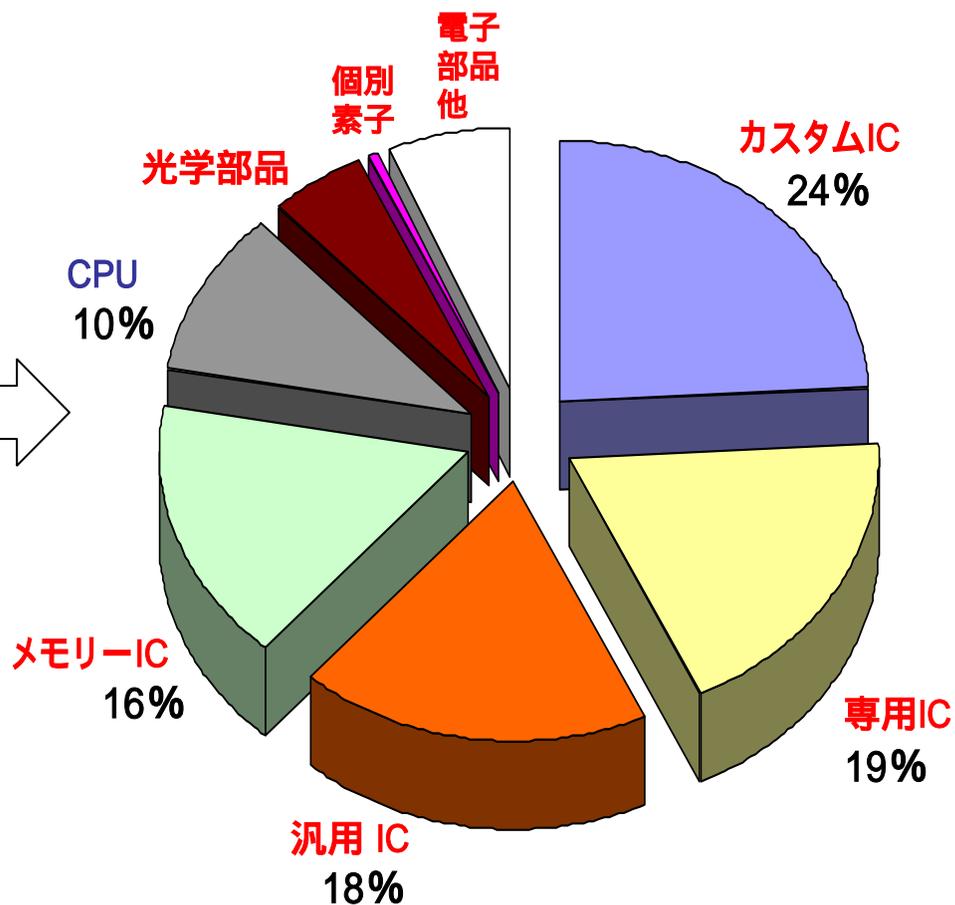
< 2008年3月期 内訳 >

売上高: 86,421百万円



< 2009年3月期 内訳 >

売上高: 74,980百万円



# 半導体及び電子デバイス事業 品目別 売上増減

品目	主な仕入先	対前年 増減率
カスタムIC	ザイリンクス、富士通	10%
専用IC	ピクセルワークス、IDT	12%
汎用IC	リニアテクノロジー、TI	8%
メモリーIC	スパンション、IDT	30%
CPU	フリースケール、富士通、TI	6%
光学部品・個別素子	アバゴ	19%
電子部品他	コーセル	13%

注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

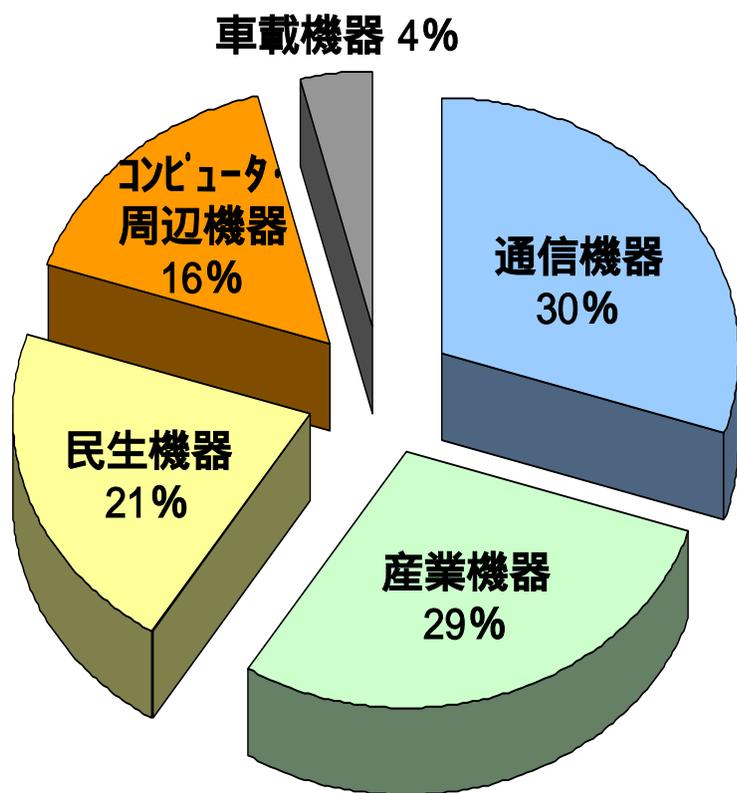
## < 主な増減 >

CPUは、商権拡大が寄与し、前年同期比6%増

その他は、下期からの受注減により減少

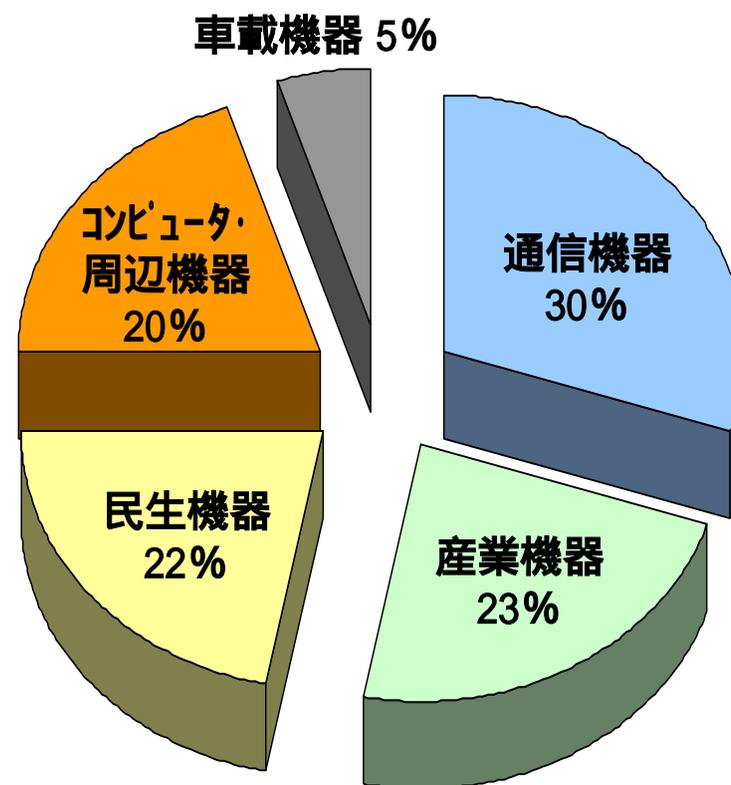
< 2008年3月期 内訳 >

売上高: 86,421百万円



< 2009年3月期 内訳 >

売上高: 74,980百万円

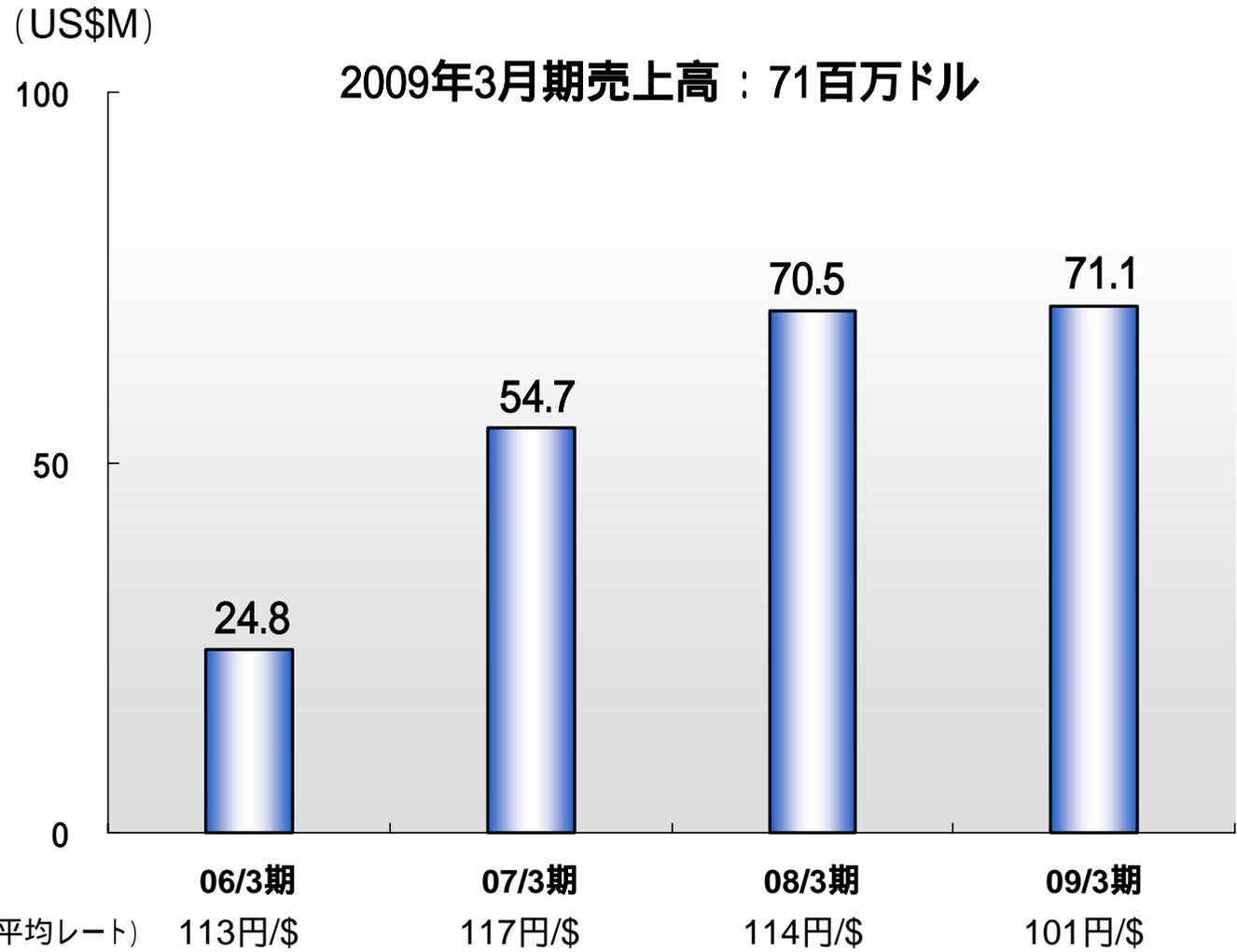


# 半導体及び電子デバイス事業 用途別 傾向

用途	主なアプリケーション	主なお客様	当社の傾向
通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、基地局	パナソニック、富士通、日立	基地局は下期に入り低調 携帯電話は通期で低調
産業機器	医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置、ロボット、計測器	東芝、パナソニック、沖	医療機器は堅調 半導体装置、FA関連は低調
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、薄型TV、AV機器	パナソニック、ソニー、シャープ	総じて低調
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター、液晶プロジェクタ、PC及び付属機器	東芝、パナソニック、エプソン	PCは上期好調も下期低調 液晶プロジェクタは通期で低調
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	パナソニック、アイシン、三菱	カーナビゲーションは比較的堅調

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

[ 売上高推移 ]



[ 営業拠点 ]

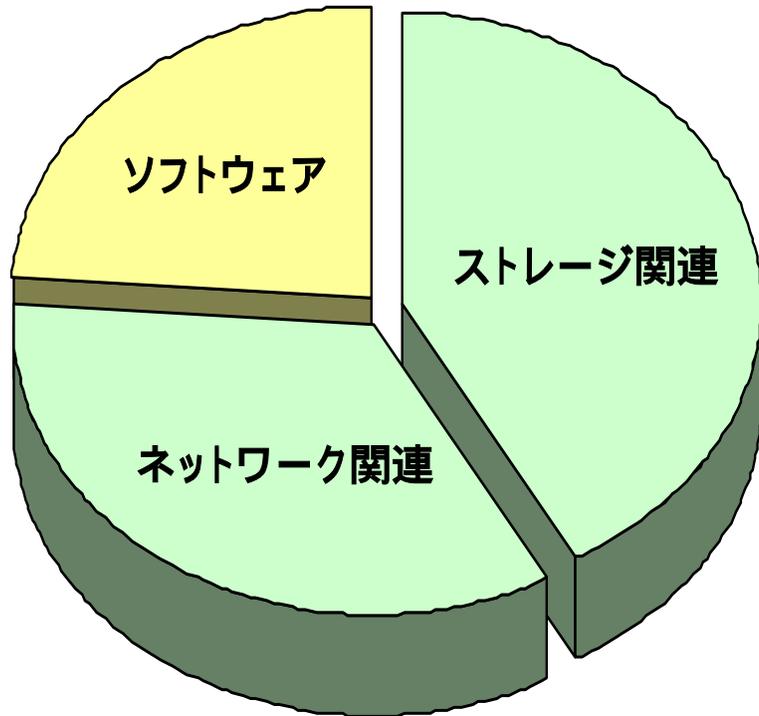
香港、上海、大連、シンガポール



# コンピュータシステム関連事業

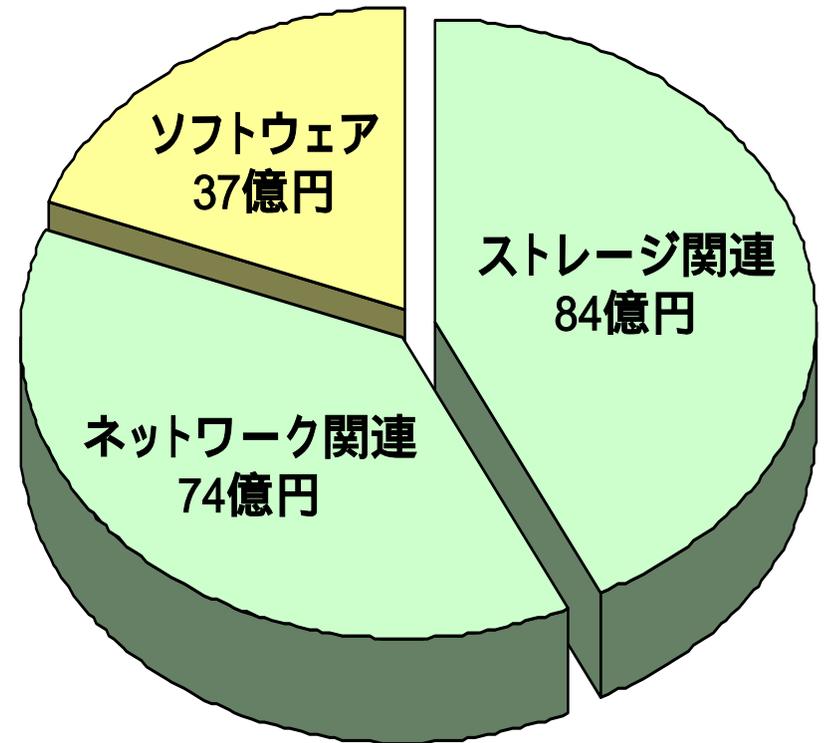
< 2008年3月期 内訳 >

売上高: 25,683百万円



< 2009年3月期 内訳 >

売上高: 19,721百万円



# 品目別売上増減要因

品目	主な仕入先	対前年増減率
ストレージ関連	ブロケード	21%
ネットワーク関連	F5ネットワークス	15%
ソフトウェア	マイクロソフト	39%

注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

## < 主な増減 >

ストレージ関連：金融機関等企業向けSANスイッチ減少

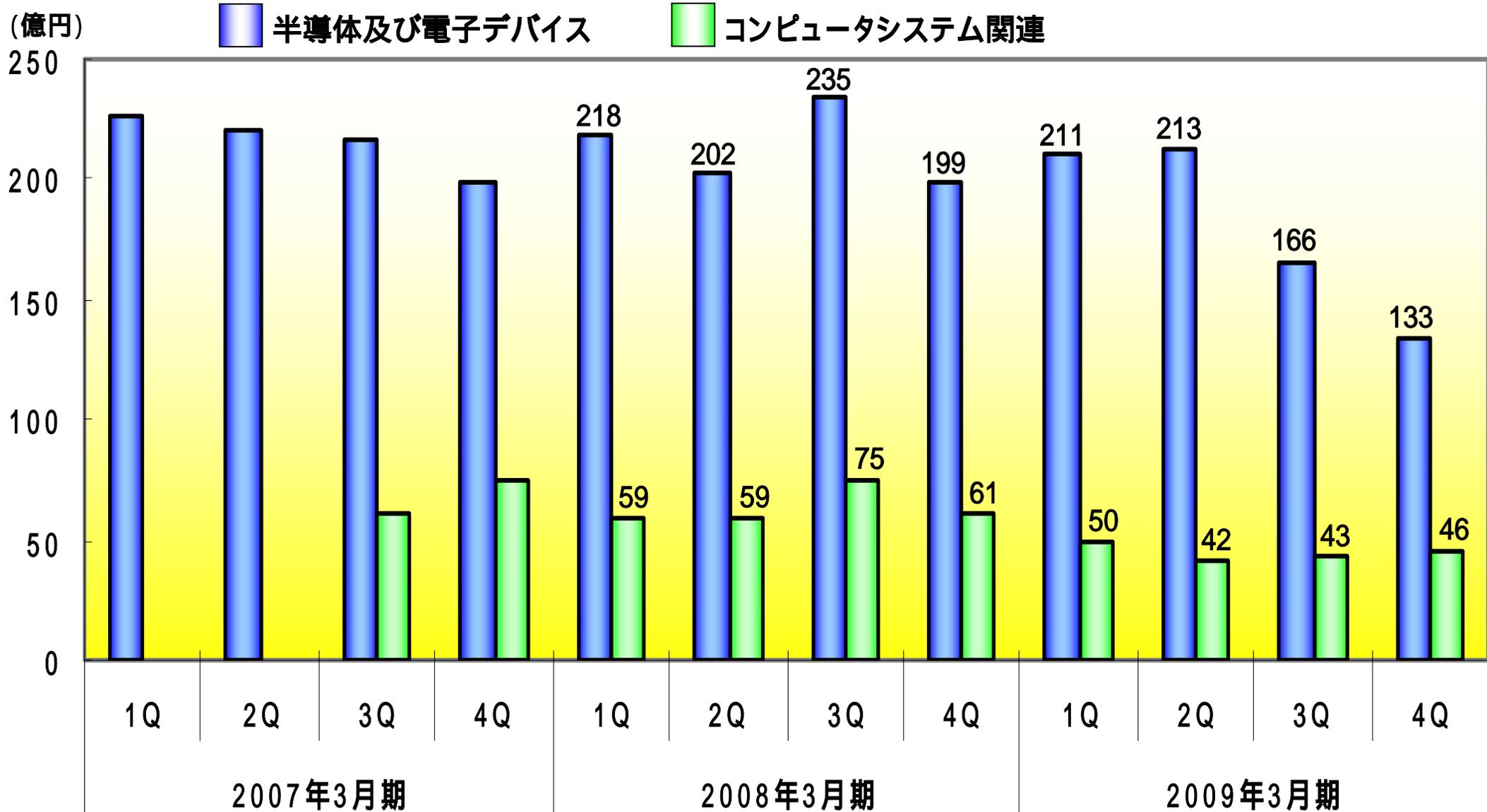
ネットワーク関連：企業のIT投資抑制の影響を受け減少

ソフトウェア：POS端末向けソフトウェア減少

純額表示に変更(売上高 = 粗利)した商品あり減少

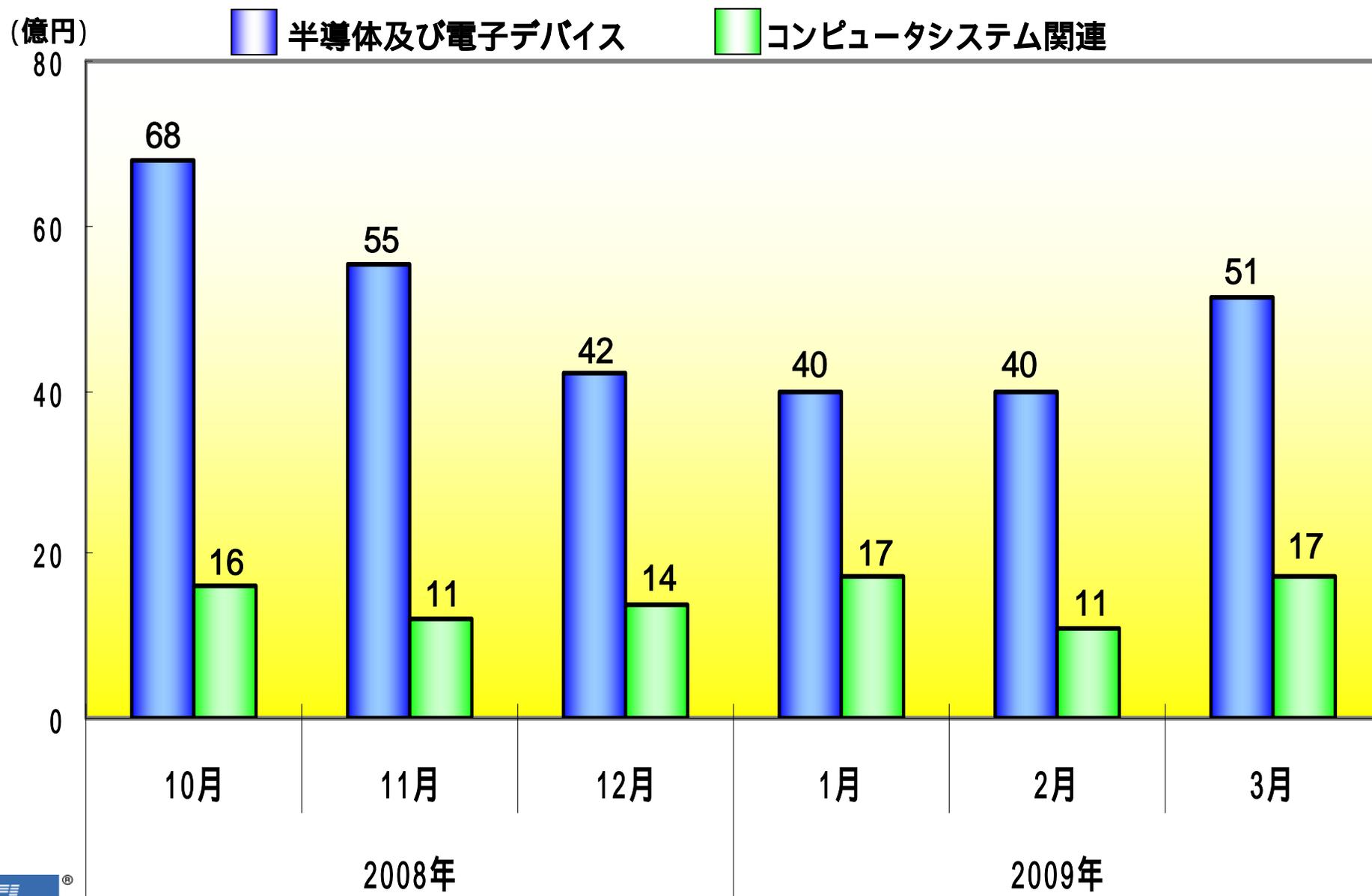
# 今期の業績予想について

# 受注高推移



\* 2008年3月期の数値はセグメント区分に組替え修正しております。

# 2009年3月期 下期月別受注高推移



# 当社を取りまく事業環境予想

## < 半導体及び電子デバイス事業 >

- ・ 半導体市場は在庫調整進み底打ち感
- ・ 産業機器の需要回復は先
- ・ 下期は緩やかな回復を想定

## < コンピュータシステム関連事業 >

- ・ 国内IT市場はマイナス成長を想定

# セグメント別連結売上高見込み

(単位:百万円)

セグメント	2009年3月期実績		2010年3期見込み		対前年 増減率 (%)
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
半導体及び電子デバイス事業	74,980	79.2	61,300	78.6	18.2
コンピュータシステム関連事業	19,721	20.8	16,700	21.4	15.3
合 計	94,701	100.0	78,000	100.0	17.6

# 2010年3月期 連結業績予想

(単位:百万円)

	上期予想	下期予想	通期予想	対前年 増減率 (%)
売上高	37,000	41,000	78,000	17.6
営業利益	360	1,090	1,450	21.2
経常利益	300	1,000	1,300	36.3
当期純利益	140	480	620	0.4
1株当たり配当金	2,500円	2,500円	5,000円	24.2

# 2010年3月期の活動方針

## 1. 利益確保に向けた体質強化

- ・ 管理可能費用のコントロールの徹底

## 2. 半導体及び電子デバイス事業

- ・ 既存顧客の深堀り及び商権拡大
- ・ 成長分野(環境/セキュリティ)へのプロモーション活動

## 3. コンピュータシステム関連事業

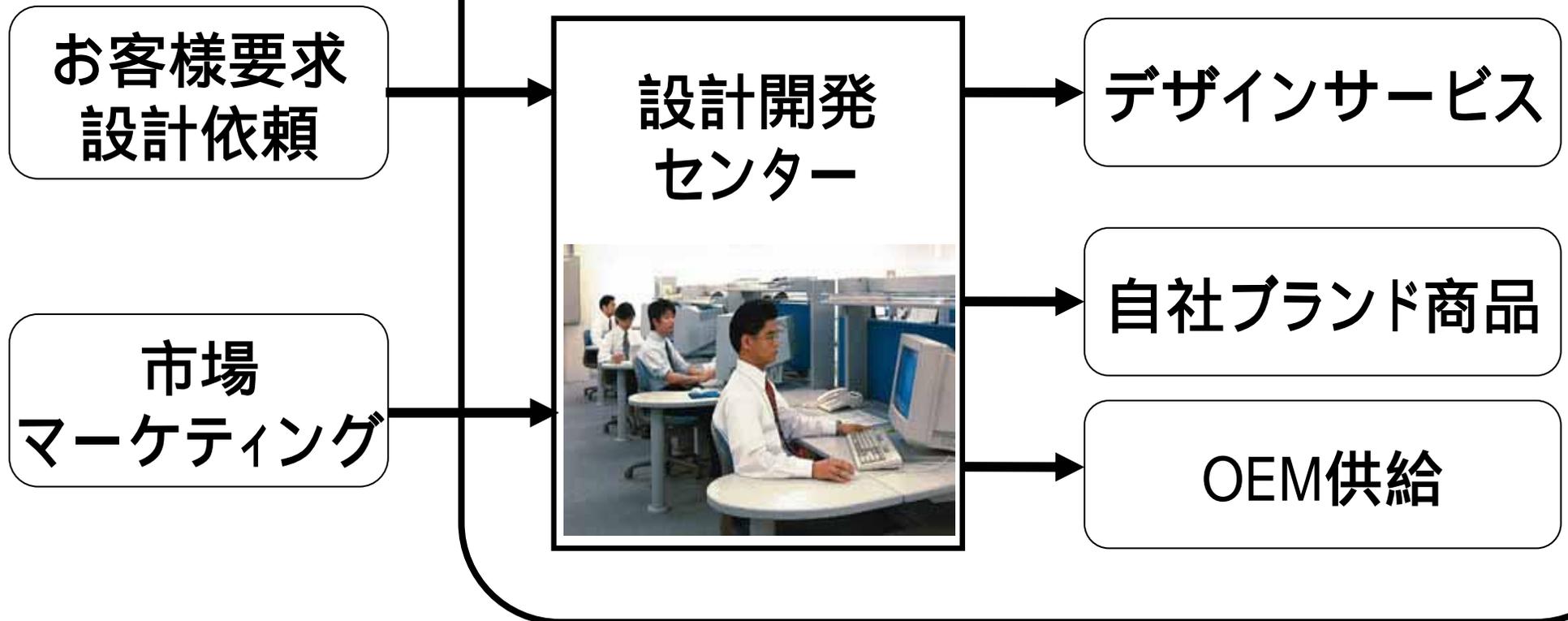
- ・ 製品別営業からアカウント営業に組織改編
- ・ 製品個々の販売からソリューション営業を強化

# 開発ビジネスについて

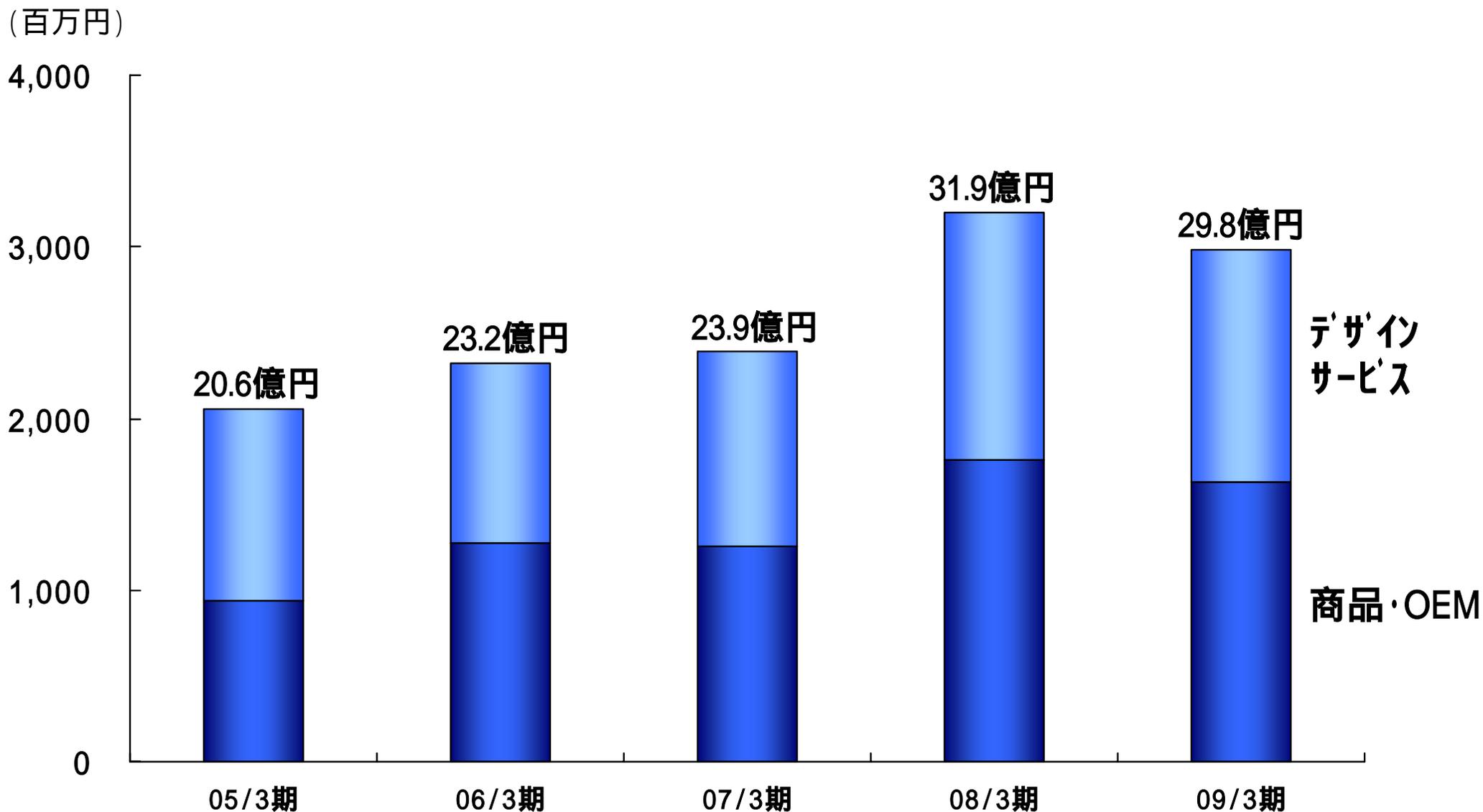
***inrevium***

(インレビウム)

## 開発ビジネス (インレビウム ビジネス)



# インレビウム売上高推移



注)06/3期以降は、連結売上高を記載しております。 25

## 映像機器用LSI

- ・人の目で見ているような自然な映像を再現
- ・監視カメラ、車載カメラなどの映像機器向け
- ・海外への販売も予定



〈元画像〉



〈TE3610PF 使用時〉

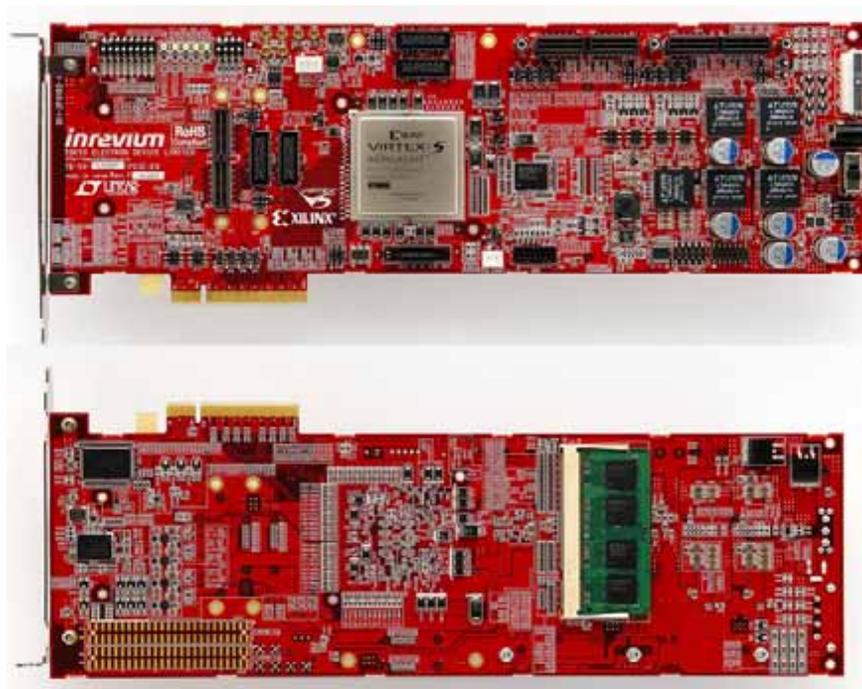


〈通常のガンマ補正〉

コントラストが消失

## LSI開発支援用評価ボード

- ・ザイリンクス社大規模FPGA (Virtex-5) 搭載
- ・LSI開発の期間短縮、費用削減に効果を発揮



< 主な応用分野 >  
計測機器、医療機器などの  
産業機器用LSI開発ツール

## < 設計受託業務、OEM >

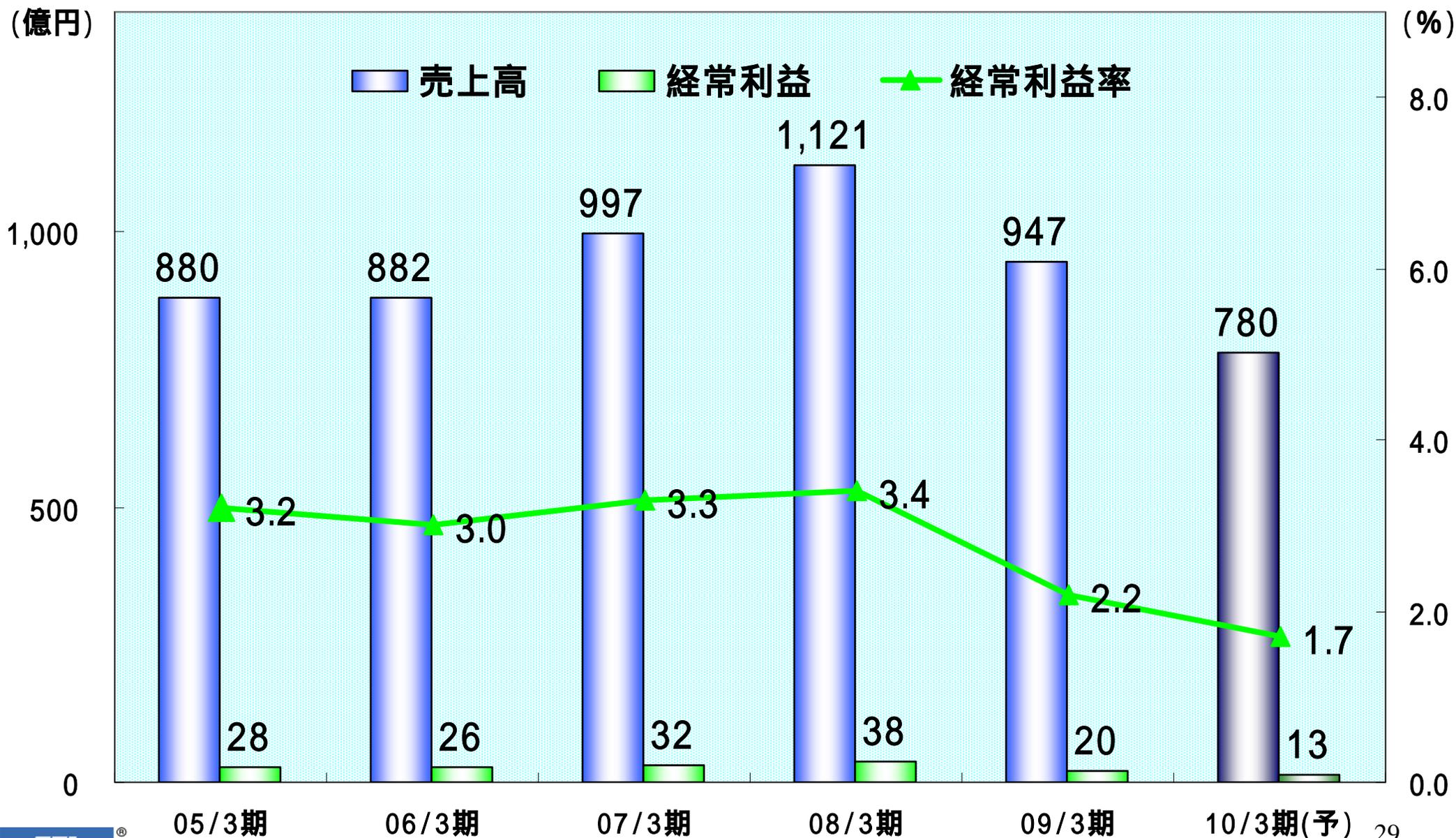
- ・ トップセールスによる営業推進
- ・ 量産供給及び品質体制の強化

## < 自社ブランド商品 >

- ・ セキュリティ関連向け商品群の拡充
- ・ F P G A搭載ボードの開発強化

# 業績推移・計画

参考資料



セグメント・品目		主な仕入先名
半導体及び 電子デバイス 事業	カスタムIC	富士通エレクトロニクス(株)、ザ'イリンクス社
	専用IC	コネクサントシステムズ'社、フリースケール・セミコンダ'クタ社、富士通エレクトロニクス(株)、IDT社、ピクセルワークス社、ザ'リンク・セミコンダ'クター社、インビ'アム
	汎用IC	リニアテクノロジー'社、オン・セミコンダ'クター社、TI 社
	メモリIC	IDT社、ラムトロンインターナショナル社、スパンシオン社
	CPU	フリースケール・セミコンダ'クタ社、富士通エレクトロニクス(株)、TI 社
	光学部品	アバ'ゴ・テクノロジー'社
	個別素子	オン・セミコンダ'クター社
	電子部品他	コーセル(株)、ダイアロジ'ック社、インビ'アム
コンピュータシステム 関連事業	ストレージ'関連	ブ'ロケート'社、エミュレックス社
	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社、センセー'ジ社

品目	主な取扱商品	機能
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリー	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品
電子部品他	ボード、電源、コネクタ	プリント配線基板の上にIC、電源、コネクタなどの 部品を実装した製品(ボード)

ストレージ関連	 A rack-mounted SAN switch device with multiple ports and a control panel.	SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。
ネットワーク関連	 A rack-mounted network switch device with multiple ports and a control panel.	インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)企業向けネットワークシステム構築機器。
ソフトウェア	 Two boxes of Phoenix security software, one orange and one blue, with a screenshot of the software interface below them.	セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のソフトウェア。

# 資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。